

導電性熱転写リボンによるレーザー熱転写で電子回路形成が可能に

平成20年10月

ゼネラルテクノロジー㈱

1. 導電性熱転写リボンとは

近年 RFID 技術による IC タグが注目を集めており、物流分野などで使用され始めていますが、まだまだ広く普及するにはコストが高いなどの問題点があるといわれています。われわれは従来のフォトリソグラフィエッチング法に代わって熱転写方式により短納期、低コストでフィルムアンテナを製造する方法を開発しました。これまで熱転写プリンタによる電気電子回路の完全無版による基板への直接形成を行って参りましたが、このたびレーザー熱転写装置による基板への直接形成を提案いたします。転写素材につきましても従来の銅薄膜に加え透明導電膜である ITO(Indium Tin Oxide)薄膜の転写についても可能になりました。

この最新技術につきましては、平成20年9月10日～12日の自動認識総合展2008(東京ビッグサイト)で、レーザー熱転写装置によるデモンストレーションを実施し、多くのお客様から好評を頂きました。また、海外におきましても、9月11日の米国ピッツバーグで開催された NIP24 (Non Impact Printing) 国際学会にて論文を発表、大きな反響を呼びました。

2. 期待される用途

タッチパネル、FPD(フラットパネルディスプレイ)の配線形成、IC タグ、カーナビゲーションシステムのフィルムアンテナ、リモートコントローラやフレキシブルコネクタの回路ボード等。

3. 従来の方式との比較

	フォトリソグラフィエッチング法	熱転写法
多品種少量生産	×	○
リードタイム	×	○
環境負荷	×	○
コスト	△	○

4. 問い合わせ先

特販二部 (Tel) 03-3833-2136 もしくは当社ホームページのお問合せページをご利用ください。

以上